# 周报

2025-09-29

## 本周研究摘要

- · ML-DSA 论文重构优化:第 3 节内容架构重组,12 个子节合并为 4 个重点技术节,精简约 60%
- · 后量子 MQTT 迁移技术调研: 建立 MQTT 协议基础理论框架, 识别 ML-DSA 四个关键影响点

## ML-DSA 论文重构优化进展

#### 第3节结构优化:

- · 建立 4 个重点技术节架构: ML-DSA 算法特征、参数集合与安全性、MQTT 协议与安全集成、ML-DSA 集成挑战
- · 新增 4 个参考文献强化学术基础
- · 研究贡献重构为条目化展示, 提升可读性

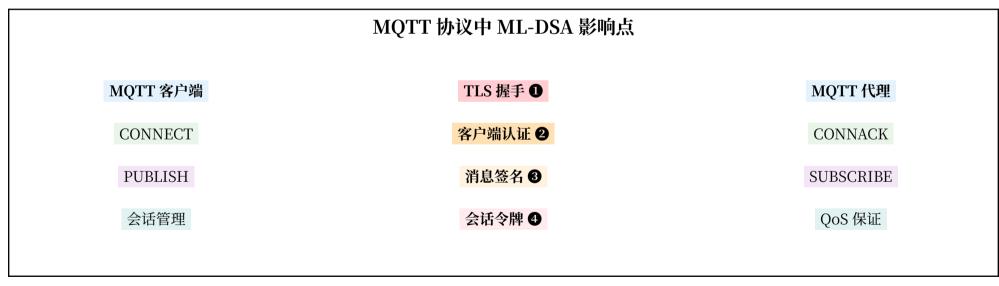
#### 核心技术内容:

- · 量化分析 ML-DSA 签名尺寸增长对 IoT 设备的性能影响
- · 整合数学基础与计算要求分析

## MQTT 协议基础与 ML-DSA 影响分析

#### MQTT 协议特征:

· 轻量级发布-订阅消息传输协议, 专为物联网设计



影响点: ●TLS 证书 ②客户端认证 ③消息签名 ④会话令牌

# ML-DSA 在 MQTT 协议中的迁移角色

$\mathbf{M}$	QTT 协议栈中 ML-DSA 迁移层次结	构
MQTT 应用层	消息完整性	ML-DSA 替换点
发布/订阅消息	载荷签名验证	消息级签名
TLS 1.3 协议层	证书验证	关键迁移点
握手认证	$DSA \rightarrow ML-DSA$	TLS 握手签名
TCP 传输层	会话建立	ML-KEM 集成
连接管理	密钥协商	密钥交换
IoT 设备层	资源约束	性能挑战
硬件限制	内存/计算	签名尺寸

## 迁移关键技术分析

#### MQTT 代理数字签名迁移路径:

- · TLS 握手阶段的服务器认证和客户端证书验证
- · 替换底层密码学原语,保持 MQTT 协议兼容性

#### 协议层级影响:

- · 应用层:可选择性集成 ML-DSA 消息级签名
- · TLS 层:更新握手流程支持 ML-DSA 证书链验证
- · 设备层: ML-DSA 签名尺寸增大(2420-4627 字节)对内存受限设备的影响

# 总结

## 下周计划

- · 深化 ML-DSA 论文 IoT 环境部署优化分析: 完善资源受限设备 性能评估框架
- · 启动 ML-DSA 实验验证系统设计:准备 ARM Cortex-M4 微控制器性能基准测试

周报 7/8

## 老师评语

#### CHES 最近一期截稿时间是什么时候?

· TCHES Volume 2026/2: 2025.10.15 Submission

· TCHES Volume 2026/3: 2026.01.15 Submission